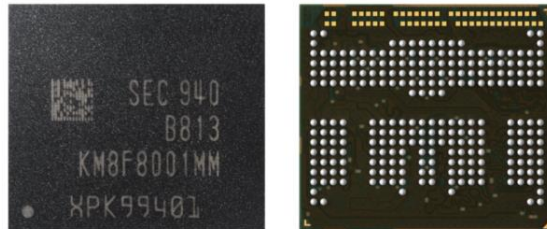


三星開始量產業界首款 12GB LPDDR4X uMCP 晶片

最大容量的 uMCP 採用業界首款 24Gb LPDDR4X 晶片

為中階智慧型手機使用者帶來 10GB 以上記憶體解決方案



全球頂尖記憶體技術領導品牌三星電子，日前在美國加州聖荷西裝置解決方案總部舉辦的 Tech Day 活動上，對外宣佈將量產業界首款 12GB 低功耗、雙倍數據傳輸速率 4X(LPDDR4X) UFS 多晶片封裝(uMCP)。

三星電子記憶體行銷執行副總裁 Sewon Chun 表示：「借助三星最頂尖的 24Gb LPDDR4X 晶片，我們不僅能為高階智慧型手機，也為中階裝置帶來 12GB 的最高行動 DRAM 容量。三星將按期開發新世代的行動記憶體解決方案，以持續支持智慧型手機製造商客戶，並為全球更多使用者帶來進化的智慧型手機體驗。」

三星甫剛發表基於 16Gb DRAM 的 12GB LPDDR4X 封裝，時隔短短七個月便又推出 12GB uMCP 解決方案。藉由在單一封裝中，結合四個 24Gb LPDDR4X 晶片(採用最新的 1y 奈米製程技術)和超快速 eUFS 3.0 NAND 記憶體，新款行動記憶體能突破目前的 8GB 封裝限制，為更廣大的智慧型手機市場供應 10GB 以上的記憶體容量^(註)。

隨著智慧型手機螢幕的需求，持續朝向更大尺寸、更高解析度的趨勢發展，在執行數據密集型任務或多工處理時，將有更多使用者能受益於三星推出的 uMCP 解決方案。憑藉著優於先前 8GB 封裝高出 1.5 倍的容量，以及每秒 4,266 Mbps 的數據傳輸速率，12GB uMCP 支援流暢的 4K 影片錄製，甚至能賦予中階智慧型手機 AI 和機器學習功能。

三星計畫迅速擴充 10GB 以上 LPDDR DRAM 產能，以滿足全球智慧型手機製造商，對更高容量記憶體解決方案日益殷切的需求，同時強化其在記憶體市場上的競爭優勢。



註：

12GB LPDDR4X uMCP：四個 24Gb(3GB)晶片+ eUFS 3.0

10GB LPDDR4X uMCP：兩個 24Gb(3GB)晶片+兩個 16Gb(2GB)晶片+ eUFS 3.0